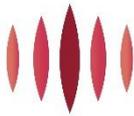




裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT_ZQSWB_2024_9_5

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input checked="" type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员单位名称及姓名	华商基金管理有限公司，康译丹 中国人寿养老保险股份有限公司，郑仁涛 银华基金管理有限公司，郭磊、范国华 中邮证券有限责任公司，吴文吉
日期时间	2024年9月20日、2024年9月23日
地点	北京市
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王文倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2024年半年度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、如何看待特斯拉称中国版及欧洲版FSD预计明年第一季度上线？</p> <p>答：在2024云栖大会上，英伟达全球副总裁、汽车事业部负责人吴新宙谈到特斯拉FSD时表示：“FSD最大的贡献是推动了业界往下一步的发展，提高了上限”。FSD作为特斯拉技术等级最高的辅助驾驶能力，能够提供导航辅助驾驶、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别等功能，这些能力目前国内部分新能源品牌都已经具备并已上路使用。吴新宙</p>



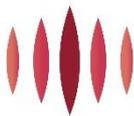
同时强调，中国车企在技术积累方面表现优异，即便与特斯拉 FSD 同台竞技，也能展现出不相上下的实力。随着汽车智能化网联化程度的加深，各大车厂的整车架构逐步从分布式架构走向域架构，逐步走向以太网为网络骨干的第三代应用。在公司后续车载以太网交换机芯片和车载高速视频传输芯片完成布局之后，将与车载以太网物理层芯片一起组成车内高速有线通信芯片系列销往各个 Tier One 或者 OEM 厂商，成为国内大陆地区车内高速有线通信芯片全覆盖的先行者。

2、公司在服务器领域是否有相关应用？

答：公司的产品与服务器有着紧密的关联，主要体现在其以太网物理层芯片和以太网网卡芯片的应用上。公司已经大规模量产的以太网物理层芯片和以太网网卡芯片均可使用在 PC 服务器产品上，并且服务器领域已成为公司的重要战略应用领域之一。这些产品的应用使得公司能够直接受益于服务器市场的增长，尤其是在运营商集采招标 PC 服务器产品时，对公司的营收有较大的直接拉升作用。此外，公司的产品还被应用于网络摄像机、交换机、网络存储、网络服务器、楼宇门禁产品等多个领域，这些产品广泛应用于汽车、工业、能源等行业，进一步证明了公司产品在服务器及相关领域中的重要性和广泛应用。公司的千兆网通以太网网卡芯片已经形成规模量产，与国产 PC 平台完美兼容，同时支持 Intel、AMD 等国际主流平台，为终端客户提供了更多选择。

3、近期市场对 2025 年-2027 年高速铜的市场预期都较为乐观，对公司有何影响？

答：根据 GB200 高速铜缆市场分析，预计 2025 年高速铜缆新增市场近 60 亿美元；Light Counting 预测至 2027 年年底，全球高速铜缆的出货量将达到 2,000 万条。公司致力于高速有线通信芯片，目前主要涉猎高速铜线传输范畴。在标准以太网下铜缆介质的最高传输速率为 10G。公司目前已量产的以太网系列芯片最高速率为 2.5G，公司在研的以太网系列芯片最高速率为 10G，初步估计公司 2025 年年底将推出该产品的量产样片，2026



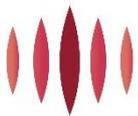
年正式量产出货。突破 10G 传输速率后，公司也将继续往铜缆超高速领域发展，不断丰富公司产品线，以期达成完善的产品布局。

4、客户端目前去库存情况

答：从公司目前的在手订单以及第二季度的整体数据情况来看，工规级产品客户端去库存情况基本结束，预计后续工规级产品出货量将进一步提升。商规级产品客户端去库存情况已经结束，但商规级产品更多的是看需求端引导出货节奏，从消费需求端是否恢复来说可能还需要有一段等待期。公司商规级产品中的新品放量随着政策端的支持以及应用场景上的国产替代已有一定的提升。车规级产品随着汽车智能化网联化程度的加深，应用空间会不断增加，预计后续会有更多公司自研的车规芯片用到更多的车型和平台上。综上，公司目前已成功跨越行业周期带来的低谷期，结合研发产品已逐步出产并放量，第二轮收获期已拉开序幕，预计后续几年将进入新一轮增长期。

5、公司上半年度在芯片生态链方面的建设？

答：2024 年上半年度，公司在终端客户需求勘探、生态圈建设、产学研合作等多个维度进行资源整合和应用。公司积极参与或发起产品应用或需求相关的活动，受邀参加“苏州市汽车芯片产业链供需对接会暨苏州高新区消费电子及新型显示产业沙龙活动”，展示了新能源汽车高速有线通信芯片解决方案。公司参与了 2024 年台北国际电脑展，接待了百名客户，并获取了新的海外潜在商机、补充了下一代产品路线图，为公司后续挖掘高端产品的应用市场提供了思维空间。另外，公司参与了中国移动产投协同“彩虹桥”终端公司专场暨智慧家庭创新生态实验室合作活动，并在小米全球核心供应商大会获得“生态链优秀供应商”荣誉称号。公司凭借高速率、高可靠性等优势，多项产品获得高度好评。2.5G 网通以太网物理层芯片 YT8821 系列产品荣获“中国 IC 风云榜年度优秀产品创新奖”。车规级产品 YT8010A 成功斩获 2023“芯向亦庄”“汽车芯片 50 强”荣誉称号；YT8011A 荣获 2024“汽车芯片编辑选择奖”，同时该产品已纳入苏



	<p>州市信息技术创新产品应用推广目录。公司与多个机构联合申报的“以太网多介质适配与远距离增强关键技术及自主芯片研发和应用”项目荣获“中国通信学会科学技术奖二等奖”，该项目中公司的代表产品为YT8510。产学研方面，公司高等技术研究院与南京邮电大学电子与光学工程学院联合成立以太网传输芯片研发中心，后续公司也将继续加强产学研合作，促进产品前瞻、技术创新、人才培养和多元协同。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>

裕太微电子
Motorcomm

